

Brucelles pour wafers en acier inoxydable 130 mm forme 3 DW à lame étagée, sans dents - Bernstein 5-421

Réf. article BS-5-421

Fabricant Bernstein

EAN 4250838506496

Ces brucelles étroites pour wafers en acier inoxydable SA possèdent une lame inférieure étagée sans dents pour une prise sans marquage sur les surfaces sensibles. La forme 3 DW convient aux wafers en verre, PCB et LCD. Avec 130 mm de longueur et 14 g, elles restent maniables et précises.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Longueur	13
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.014 kg



DESCRIPTION

La forme 3 DW étroite des Bernstein 5-421 manipule les wafers sensibles en douceur grâce à une lame inférieure étagée sans dents, pour un contact sans marquage.

AVANTAGES

- Lame inférieure étagée sans dents pour une prise douce et sans marquage
- Forme 3 DW adaptée aux wafers, PCB et LCD
- Acier inoxydable SA à surface mate polie et sans reflets
- Acier chrome-nickel austénitique offrant une bonne résistance à la corrosion
- Seulement 14 g pour 130 mm de longueur, pour un travail stable et précis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Lame	lame inférieure étagée, sans dents, étroite
Forme	forme 3 DW
Matériau	acier inoxydable SA
Surface	mate polie, lisse et sans reflets
Longueur totale	130 mm
Poids	14 g

UTILISATION

Elles conviennent au positionnement et à la préhension de composants plats et fins tels que des wafers fragiles (wafers en verre) ou des PCB et LCD extrêmement sensibles.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- EAN 4250838506496
- Code douanier 82032000
- Pays d'origine Italie